

高速高精度フリップチップボンダの開発、販売

当社はこの度、接合精度と処理速度を大幅に向上させた高速高精度フリップチップボンダFDB200型を開発しました。そして販売活動の開始にあたり、来る12月5日～7日に幕張メッセで開催されるセミコンジャパン2007に出展いたします。

近年情報通信やデジタル家電の分野で、製品の高性能化、小型薄形化が進み、その中に用いられる半導体の小型化も急速に進んでいます。これに伴い、基板の配線パターンに半導体チップの電極を直接接続するフリップチップ接続形態の採用が拡大しております。今後さらに小型化が加速するのに伴い、配線ピッチの微細化が進み、その要求接続精度はますます高くなると予想されます。

当社では、既にフリップチップボンダを商品化しておりますが、高速化、高精度化といった急激な市場ニーズの高度化に応えるため、今回FDB200型を開発したものです。

チップ供給機構、ボンディング機構、基板搬出入機構は各種ユニットからニーズに合わせて選択できます。

主な特徴

- 1．タクトタイム1.6秒の高速ボンディング。
- 2．グレースケール/サブピクセル画像処理、リニアスケール位置制御、カメラキャリブレーション機構などによる高精度ボンディング
- 3．チップ供給方法はウエハ供給またはトレイ供給が選択可能で、トレイの場合には複数種混在供給も可能。
- 4．低荷重ボンディングも可能。

主な仕様

基 板 寸 法：100×40～250×150mm

チ ャ イ プ 寸 法：0.3×0.3～20×20mm

タクトタイム：1.6秒/チップ（諸条件により異なる場合があります）

精 度：2μm（諸条件により異なる場合があります）

機 械 寸 法：長さ1200mm 幅1700mm 高さ1600mm

本機の価格は仕様により異なりますが、3,500～4,000万円で、年間30台の販売を見込んでいます。

以上